



일시

2017년 5월 26일(금)

장소

코엑스 컨퍼런스룸(남) 327호

주최

화학경제연구원 컨설팅사업부

프로그램

Time	Contents	Speaker
[Session 1]	기능성 점·접착소재 및 응용기술	
10:00 - 10:40	기능성 점·접착 원료 및 응용 기술 동향 - 기능성 점·접착 원료 연구 동향(친환경, UV, 수성, 향균 등) - 산업별 적용 동향 및 점·접착 설계 기술 - 기능성 점·접착·테이프 원료 및 기술 전망	애경화학 심종배 본부장
10:40 - 11:20	기능성 점착필름 시장 및 기술 전망 - 기능성 점착 필름의 이해 및 시장 이슈 - 전자산업(디스플레이/모바일 등) 변화에 따른 개발 및 사업화 방향	SKC Haas 김승수 부장
11:30 - 12:10	멤브레인형 LNG 선박(GTT Mark III)에 사용되는 우레탄계 접착제 - 우레탄 접착제의 이해 및 특성 - 접착제 물성 테스트 방법 - GTT 인증 Process 소개 및 LNG 선박용 접착제 기술 전망	SKC 안병욱 수석연구원
12:20 - 13:20	점심식사	
[Session 2]	스페셜티 용도 개발 동향	
13:30 - 14:10	차세대 유연투명전극 상용화에 따른 점·접착 개발 전망 - 유연투명전극 이슈 소개 - Embedded 구조 및 자기치유 유연투명전극의 이해 - 유연투명전극 상용화에 따른 점·접착 소재 및 기술 개발 전망	전자부품연구원 김영민 박사
14:20 - 15:00	접착제를 이용한 자동차부품의 이중재질접합 - 미래형 자동차의 동향 - 접착제의 특성 - 복합소재 및 플라스틱 소재의 접착	헨켈 이동하 이사
15:10 - 15:50	반도체 패키징용 점·접착·필름 기술 동향 - 플렉서블 반도체용 패키징 재료 및 기술 동향 - 응용 산업 및 적용사례(웨어러블/디스플레이/메디컬/센서 등) - 향후 기술 로드맵 및 전망	하나마이크론 임재성 수석연구원
16:00 - 16:40	전자소재용 점·접착 테이프/필름 시장 및 기술 개발 현황 - 디스플레이용 Direct Bonding 시장 동향 (OCA, OCR) - QD TV용 Sheet 제조에서의 점·접착 기술 - 전자소재용 Tape 시장 및 기술 (2 차 전지용 Tape, Foam Tape등)	테이팩스 남병기 연구소장

* 프로그램 주제 및 일정은 연사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

연사 및 강의 초록

기능성 점·접착 원료 및 응용 기술 동향

애경화학 / 심중배 본부장

본 강의에서는 용도별 점·접착제의 최신 기술동향을 살펴보기에 앞서 기능성 점·접착 원료에 대한 이해와 이에 따른 설계기술에 대해 살펴보고자 한다. 아울러 친환경, UV, 수성, 향균 등 기능성 점·접착 소재의 다양한 활용분야와 향후 원료 기술에 대해 전망한다.

기능성 점착필름 시장 및 기술 전망

SKC Haas / 김승수 부장

본 강의에서는 기능성 점착필름에 대해 알아보고 관련 시장 이슈에 대해 살펴본다. 또한 디스플레이, 모바일 등 전방산업 변화에 따른 점착필름의 개발 및 향후 사업화 방향에 대해 논의함으로써 기능성 점착필름의 미래 가능성에 대해 조망하고자 한다.

멤브레인형 LNG 선박(GTT Mark III)에 사용되는 우레탄계 접착제

SKC / 안병욱 수석연구원

LNG 선박은 구조의 특성상 LNG를 저장하는 화물창 시스템이 선박의 성능을 결정하는 가장 중요한 부분이다. 화물창 시스템 구성에 LNG의 극저온 조건에서 선박의 안정성을 부여하기 위해 우레탄 Insulation Panel이 사용되는데 이를 견고하게 기밀성에 문제가 없도록 사용하는 핵심기술이 LNG 선박용 접착제이다. 본 강의에서는 LNG 선박용 접착제 중에서 폴리우레탄계 접착제에 대해 소개하고자 한다.

차세대 유연투명전극 상용화에 따른 점·접착 개발 전망

전자부품연구원 / 김영민 박사

차세대 모바일 디스플레이는 디자인 자유도가 높아지면서 지금의 유리투명전극을 대체하는 유연투명전극을 요구하고 있다. 유연투명전극은 접히거나 늘어나는 특성을 지니면서 높은 신뢰성을 확보하는 것이 중요한데, 본 세미나에서는 이러한 특성을 확보하기 위한 embedded 구조 유연투명전극과 자기치유 유연투명전극 관련 연구 동향을 소개하고자 한다. 또한, 플라스틱 기재로 전극 소재가 바뀔 때 따라 요구되는 점착제 개발 이슈 및 방향에 대해 논의하고자 한다.

접착제를 이용한 자동차부품의 이종재질접합

헨켈 / 이동하 이사

미래의 자동차에 요구되는 친환경적 특성은 경량화를 필수적으로 동반하며, 이로 인해 자동차 부품에서 스틸의 비중이 낮아지는 동시에 각종 수지와 경금속의 비중이 높아지는 추세에 있고, 이와 같은 소재들을 결합하는 방식으로 접착제에 대한 관심이 높아지고 있다. 이에, 본 강의에서는 플라스틱, 복합소재 등을 결합하는 Solution으로서 접착제가 갖는 일반적인 특성, 종류별 장단점, 요구사항, 한계와 개발동향 등을 전반적으로 조망한다.

반도체 패키징용 점·접착·필름 기술 동향

하나마이크론 / 임재성 수석연구원

본 강의에서는 반도체 패키징용 재료에 대한 전반적인 소개와 점·접착·필름의 적용 및 기술동향에 대해 살펴보기로 한다. 특히 플렉서블 반도체용 패키징 기술에 대해 소개하고 웨어러블/디스플레이/메디컬/센서등 실제 적용되고 있는 사례를 통해 반도체 패키징의 향후 기술 로드맵을 제시한다.

전자소재용 점·접착 테이프/필름 시장 및 기술 개발 현황

테이팩스 / 남병기 연구소장

디스플레이 시장은 LCD, OLED, QD 등 구동방식 발광 재료적 관점에서 빠르게 변화가 일어나고 있다. 소프트웨어 성능도 고집적화되어 가고 있고, 외관 디자인 관점에서도 Flat 형태에서 Edge 형태 시장이 급격히 늘어날 조짐을 보이고 있다. 따라서, 이러한 변화에 보조를 맞추기 위해 점·접착·테이프/필름 시장에서 진행되고 있는 기술적 노력과 시장변화에 대해서 간략히 살펴보기로 한다.

등록 안내

참가비

구분	신청시기	금액	그룹 할인
Early Bird	04/12-04/26(18시 마감)	30만원(VAT별도)	· 3인 이상 신청 시 전체금액의 10% 할인 * 홈페이지 일괄신청 시 할인적용 가능 (개별 신청시 할인적용 불가)
일반등록	04/27-05/24 (18시 마감)	35만원(VAT별도)	
현장등록	05/25-05/26 * 선착순 마감될 경우 현장등록 불가	40만원(VAT별도)	

·세금계산서는 참가신청 당일 발행되며, 참가비는 5 영업일 내 입금을 원칙으로 합니다.

신청방법

- 인터넷 신청 (<http://www.cmri.co.kr/>)
- 홈페이지 접속 → 무료회원가입 → 로그인 → 원하는 프로그램 클릭 → 신청하기 → 온라인결제 → 접수완료

취소 및 환불 규정

- 세미나 10일 전까지(~ 05/16 18:00) 100% 전액 환불 가능하며, 9일 전부터는 환불되지 않습니다.
- 계좌이체를 통해 결제된 경우 이체일로부터 10일 내에만 환불가능하며 거래 수수료는 환불되지 않습니다.

문의

- 세미나 관련 문의: 세미나팀 (02-6124-6660~8 ext. 504, seminar@chemlocus.com)
- 세금계산서 관련 문의: 총무팀 (02-6124-6660~8 ext. 204, chemj@chemlocus.com)

기타

- 한정된 좌석 수로 인하여 조기 접수마감 될 수 있습니다.
- **일반등록 기간 내라 하더라도 현장결제를 선택한 경우 현장등록 참가비가 적용됩니다.**
- 현장결제 선택 후 사전 고지 없이 불참하는 경우, 향후 화학경제연구원이 제공하는 서비스 이용에 불이익이 있을 수 있습니다.
- 모든 참가자에게는 책자형 자료집, 전자형 자료집(PDF), 점심식사가 제공됩니다.
- 주차는 유료이며 별도로 지원되지 않으므로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
- **사전 등록자라 하더라도 행사 시작 2시간 이후 도착 시 좌석 이용에 불편함이 있을 수 있습니다.**

장소 안내

- 서울특별시 강남구 영동대로 513 (삼성동, 코엑스) 컨퍼런스 룸(남) 327
(주차장은 지하 2층 D구역을 이용하시면 편리합니다)

[코엑스 교통 안내>](#)

